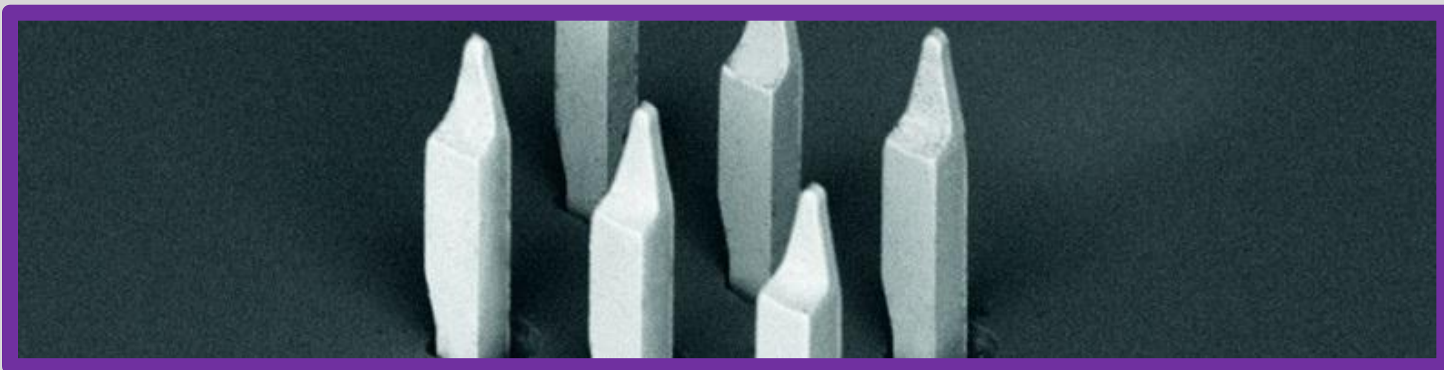




SV TCL & ASSOCIATES PROBE COMPANY

LogicTouch™ Fina Pitch Vertikal

Krympningen av IC die geometrier och den ökande komplexiteten i enhet mönster gör uppgift om-wafer testa allt svårare. SV TCL LogicTouch passar perfekt för dessa typer av avancerade mönster, en fin pitch-teknik använder en MEMS-stil sond måltavlan för pad-begränsad enheter som hög volym SoCs, mikrokontroller, DSPs och 3D paket. LogicTouch är också idealisk för de senaste enheten applikationer inklusive TSV (Genom-Kisel Via) och Koppar Pelaren (Cu-Pelaren).

- Fine Pitch anlagen till 50µm
- Inga Chip designbegränsningar
    - -- Sonden matriser
    - -- Hörnet kuddar
- Enkel Pin repareras
- MEMS - Style sonder
    - -- Större Scrub konsekvens
    - -- Mer tredimensionell kontroll

Kontakta din SV TCL representant så kan vi hjälpa dig att hitta rätt LogicTouch produkt för vertikal provning behov.